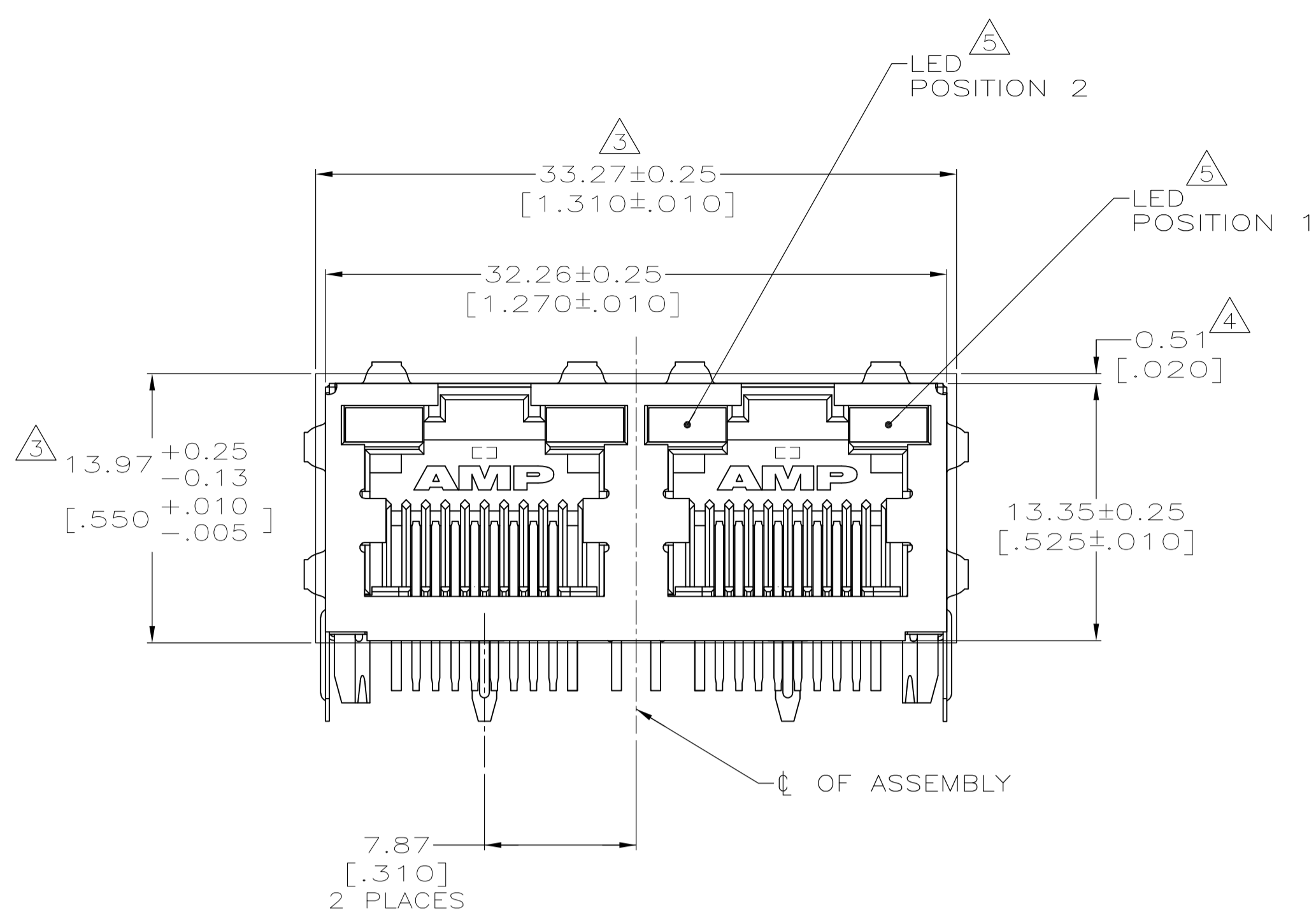
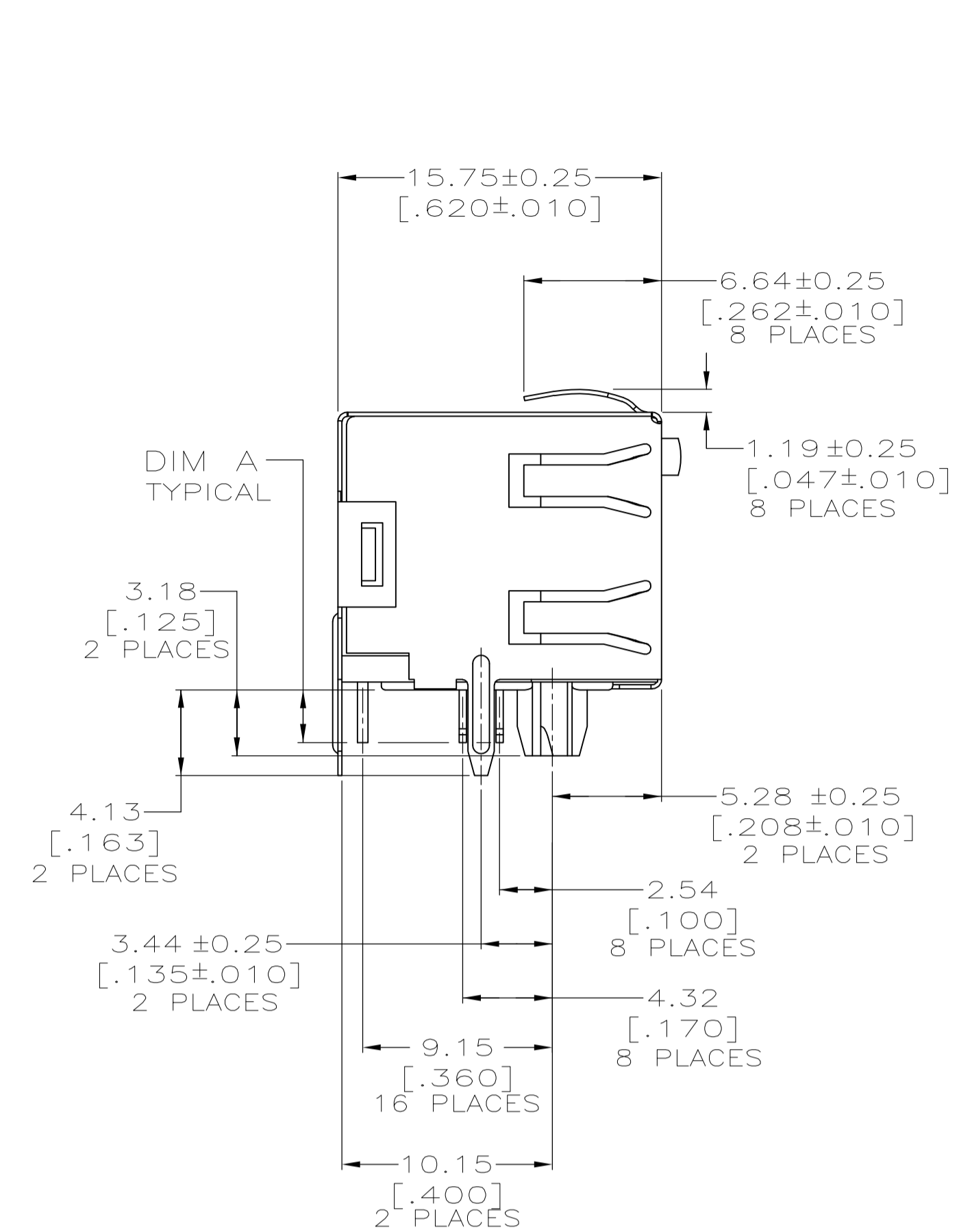
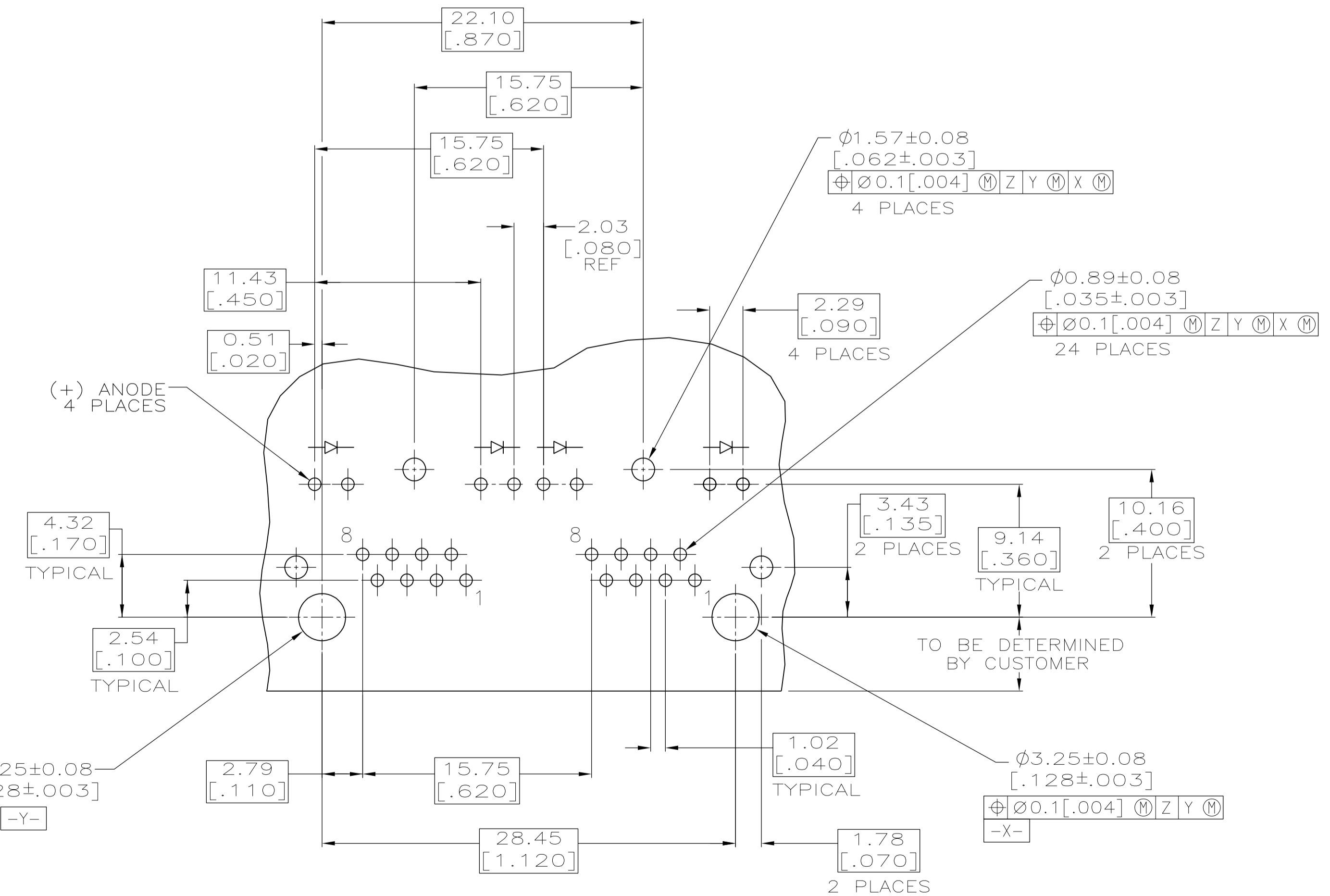
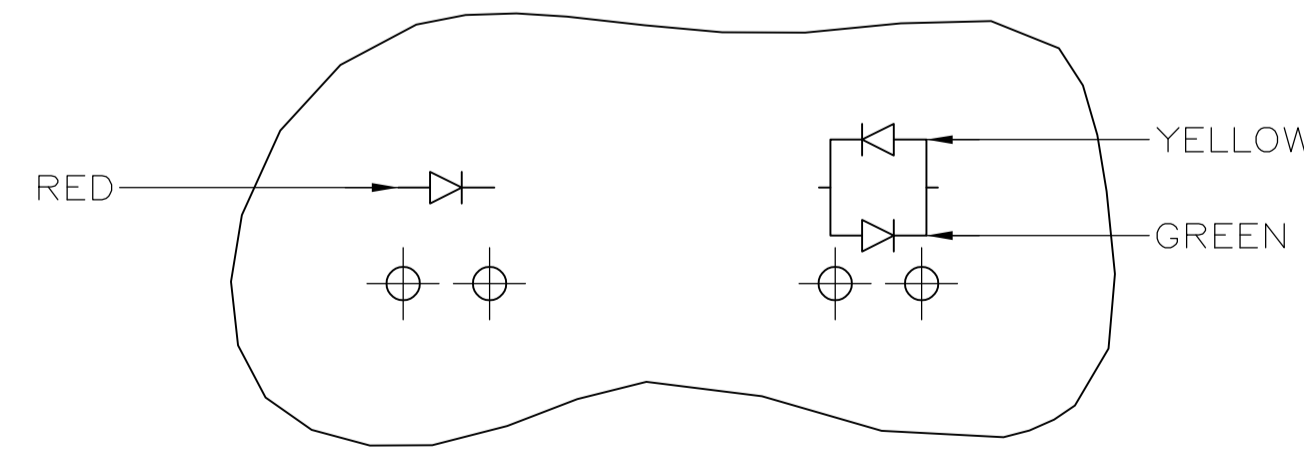
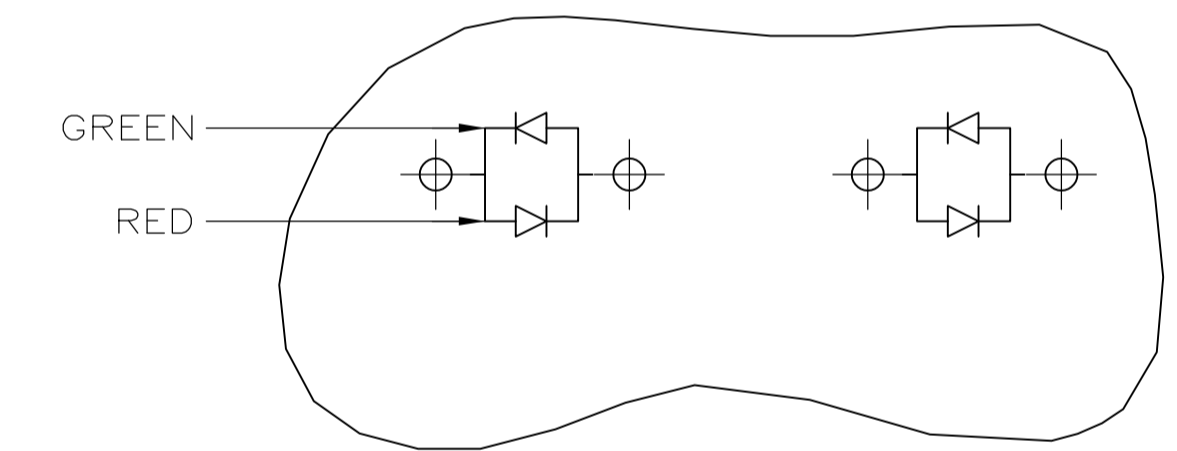
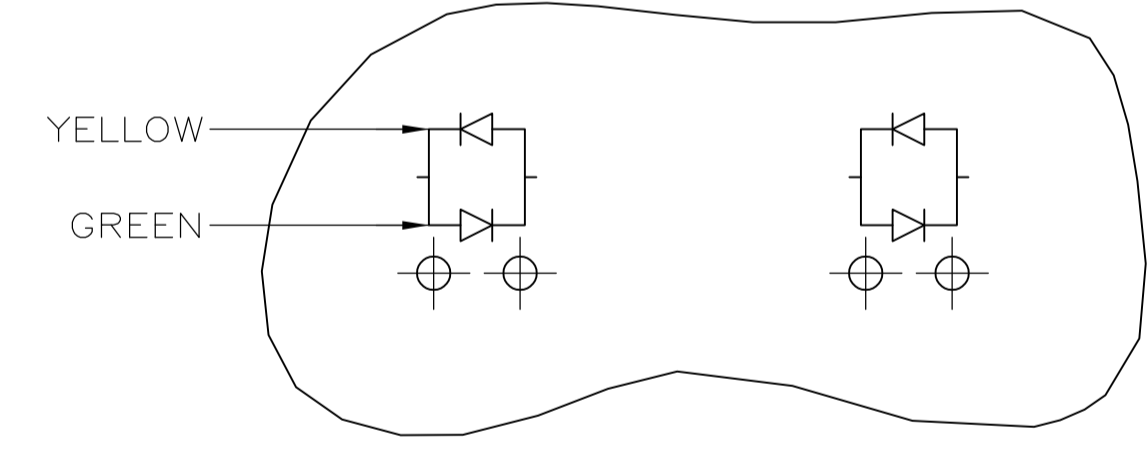
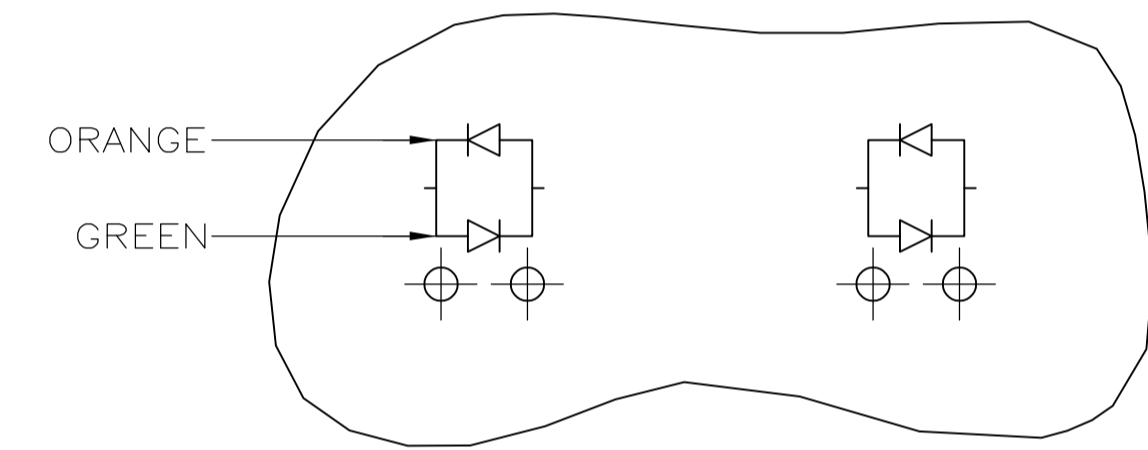


LOC	DIST	REVISIONS					
AA	00	REV	PER	ECO	DATE	BY	APPV
E		REV PER	ECO-13-000217		31DEC2012	DZ	AC



- MATERIAL:
HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0.
TERMINALS - 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81µm[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27µm [.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27µm [.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
SHIELD - 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 1.27µm[.000050] MINIMUM SATIN NICKEL WITH 2.03µm[.000080] MINIMUM TIN POST DIPPED ON PCB GROUND TABS.
LIGHT EMITTING DIODE (LED) - DIFFUSED EPOXY LENS, 0.51 x 0.51[.020 x .020] CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89µm THICK Sn/Cu OVER 2.03µm THICK Ag OVER 1.02µm THICK Cu OVER 3.56µm THICK Ni OVER 1.02µm THICK Cu UNDERPLATE
- JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.
- SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.
- SEE TABLE FOR COLOR OF LEDS AND NUMBER REQUIRED.
- THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.
- OBsolete PARTS: OBsolete CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- TAPE & REEL PACKAGING, FULLY ESD COMPLIANCE.



INDICATOR COLOR FOR EACH HOUSING	POSITION 2	POSITION 1	PART NUMBER
2.54 [.100]	YELLOW	GREEN	3-6116353-2
3.05 [.120]	YELLOW	GREEN	3-6116353-1
3.55 [.140]	RED/GREEN	RED/GREEN	2-6116353-9
3.05 [.120]	YELLOW/GREEN	YELLOW/GREEN	2-6116353-8
3.05 [.120]	GREEN	GREEN	2-6116353-4
2.54 [.100]	RED	YELLOW/GREEN	2-6116353-3
2.54 [.100]	RED/GREEN	RED/GREEN	1-6116353-3
3.55 [.140]	YELLOW	GREEN	6116353-9
2.54 [.100]	YELLOW/GREEN	YELLOW/GREEN	6116353-8
2.54 [.100]	ORANGE/GREEN	ORANGE/GREEN	6116353-7
2.54 [.100]	YELLOW	YELLOW	6116353-6
2.54 [.100]	GREEN	GREEN	6116353-5
2.54 [.100]	GREEN	YELLOW	6116353-4
2.54 [.100]	YELLOW	-	6116353-3
2.54 [.100]	-	GREEN	6116353-2
2.54 [.100]	YELLOW	GREEN	6116353-1

SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT (COMPONENT SIDE)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DL DRUMMOND/L.A.MAYER

TE Connectivity

INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X2, SHIELDED, PANEL GROUND, WITH LEDS

108-1163-4

114-2154

00779-6116353

SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV E



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.